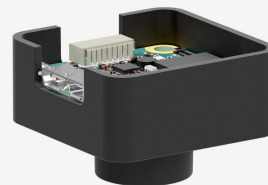
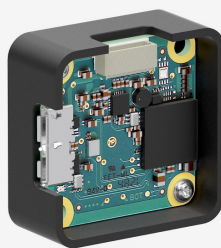


■ 量産中

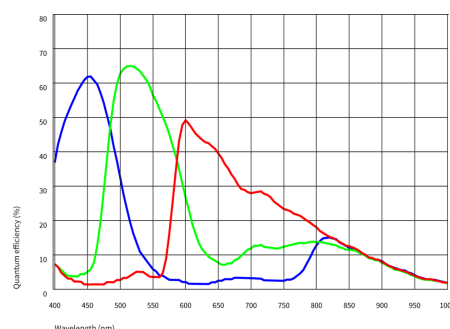
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS カラー
シャッター	ローリングシャッター
特性	リニア
読み出しモード	プログレッシブスキャン
解像度/ピクセル	12 MP
有効画素数	12.33 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	4056 x 3040 ピクセル
アスペクト比	4:3
ADC	12 bit
色深度 (カメラ)	12 bit
光学センサークラス	1/2"
撮像面積	6.287 mm x 4.712 mm
光学センサーの対角	7.86 mm (1/2.04")
画素サイズ	1.55 µm
マイクロレンズシフト	12.00
メーカー	Sony
センサーモデル	IMX412-AACK-D
ゲイン (マスター/RGB)	-/-
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	24 / 12
AOI 画像の高さ、ステップ幅	32 / 8
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	2 / 4
ビニング水平	増加したフレームレート
ビニング垂直	増加したフレームレート
ビニング手法	M/C 自動
ビニング係数	2
サブサンプリング水平	-
サブサンプリング垂直	-
サブサンプリング手法	-
サブサンプリング係数	-



技術は変更されることがあります (2024-05-03)

ページ 1 の 3

www.ids-imaging.jp

IDS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com

モデル

フレームレートフリーランモード (8ビットモード)	18 fps
フレームレートトリガー (連続)	18 fps
フレームレートトリガー (最大)	18 fps
露出時間 (最小 ~ 最大)	0.032 ms - 1900 ms
消費電力	0.5 W - 1 W

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

PCB バージョンについては、該当するドキュメントのヒントを参照してください。

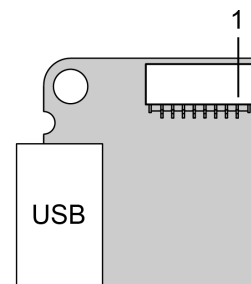
操作中のデバイス温度	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
保管中のデバイス温度	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
湿度 (相対湿度、結露なし)	20 % - 80 %

コネクター

インターフェースコネクター	USB 3.0 micro-B
I/O コネクター	8 ピンコネクター
電源	USB ケーブル

ピン割り当て I/O コネクター

1	電圧出力 3.3 V
2	接地 (GND)
3	オプトカプラなしのフラッシュ出力 - Line 1
4	オプトカプラなしのトリガー入力 - Line 0
5	汎用入出力 (GPIO) 1 - Line 2
6	汎用入出力 (GPIO) 2 - Line 3
7	接地 (GND)
8	USB 給電: 5 V、最大 400 mA



設計

レンズマウント	S-Mount
保護構造	-
外形寸法	32.5 mm x 32.5 mm x 14.0 mm
重量	13 g

Features

Image Acquisition

Freerun	✓
Software trigger	✓
Hardware trigger	✓
Trigger controlled exposure	-
Denoiser	-
Long exposure	-
Line scan	-
Line scan highspeed	-
Global start	-

Flashing

Flashing	-
PWM flashing	-

技術は変更されることがあります (2024-05-03)

ページ 2 の 3

www.ids-imaging.jp

IDS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com

Image Adjustments	Auto exposure	-
	Auto gain	-
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	-
	LUT	-
	Mirror/flip	X/Y
On-board Image Processing	Pixel formats	BayerGR10g40IDS BayerGR12g24IDS
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	-
	Decimation (Sensor)	-
	Binning (FPGA)	-
	Binning (Sensor)	2x2 Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others	Chunks	-
	Sequencer	-
	Events	-
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	3.3